

8-146455-8 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU Headers

TE 内部编号 8-146455-8

PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 38 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Unshrouded, Tin, Through Hole - Solder, Signal, AMPMODU Headers

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



连接器系统: 板对板

位数: 38

行数: 1

中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

PCB 安装方向: 垂直

## 产品特性

### 产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| 连接器系统       | 板对板      |
| 接头类型        | 不带罩      |
| 可密封         | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |

### 结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 是  |
| 位数       | 38 |
| 行数       | 1  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 绝缘电阻 | 5000 MΩ |
|------|---------|

### 主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 连接器外形  | 标准 |
| 主要产品颜色 | 黑色 |

### 接触件特性

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 端子接触部长度 | 2.79 mm [.109 in] |
|---------|-------------------|



|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 接合方柱尺寸         | .64 mm[.025 in]               |
|                | 50 μin                        |
| 端子布局           | 直插式                           |
| 端子接合区域电镀材料厚度   | 2.54 – 5.08 μm[100 – 200 μin] |
| 端子形状和构造        | 正方形                           |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 锡                             |
| 端子基材           | 铜合金                           |
| 端子接触部电镀材料      | 锡                             |
| 端子类型           | 插针                            |
| 端子额定电流（最大值）    | 3 A                           |
| <b>端接特性</b>    |                               |
| 方形端接柱体和尾部尺寸    | .64 mm[.025 in]               |
| 端接柱体和尾部长度      | 3.3 mm[.13 in]                |
| PCB 端接方法       | 通孔 - 焊接                       |
| <b>机械附件</b>    |                               |
| 连接器安装类型        | 板安装                           |
| 接合对准           | 不带                            |
| PCB 安装对准       | 不带                            |
| PCB 安装固定       | 不带                            |
| <b>壳体特性</b>    |                               |
| 外壳材料           | 热塑性                           |
| 中心线（间距）        | 2.54 mm[.1 in]                |
| <b>尺寸</b>      |                               |
| 堆叠高度           | 5.08 mm[.2 in]                |
| PCB 厚度（建议）     | 1.4 mm[.055 in]               |
| <b>使用环境</b>    |                               |
| 工作温度范围         | -65 – 125 °C[-85 – 257 °F]    |
| <b>操作/应用</b>   |                               |
| 装配工艺特点         | 拾放盖, 拾放盖                      |
| 电路应用           | Signal                        |
| <b>行业标准</b>    |                               |
| 与已批准的标准产品兼容    | CSA LE7189, UL E28476         |

UL 阻燃性等级

UL 94V-0

### 包装特性

封装方法

Carton

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)  
不含REACH SVHC

卤素含量

低溴/氯 - 每种均质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

波峰焊接可达到 265°C

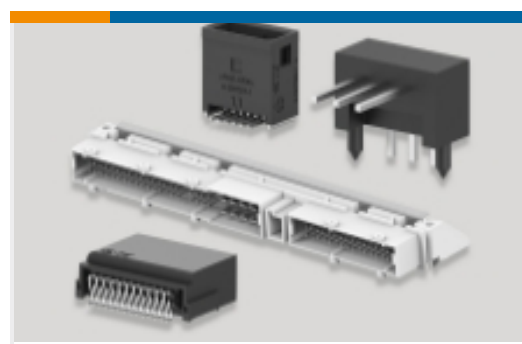
#### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件



### 该系列中的其他产品 | AMPMODU Headers



PCB 板端连接器及母端(4379)



线到板连接器组件和护套(5)



连接器盖帽(1)

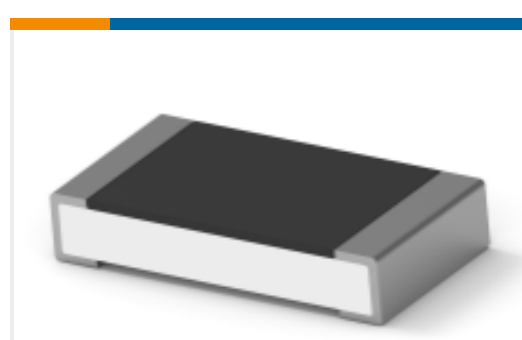
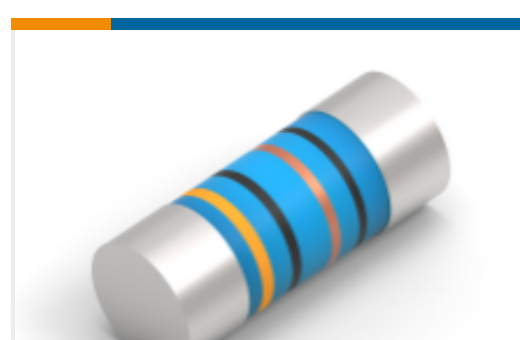
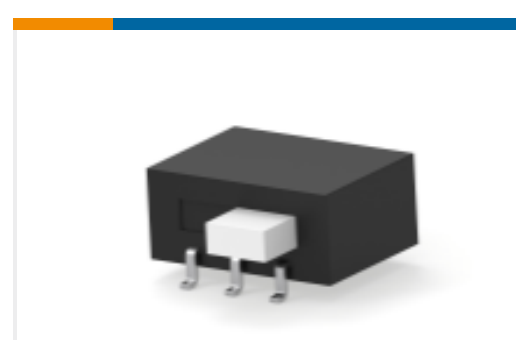


连接器硬件(2)



连接器端子(64)

## 客户还购买了

TE 产品编号1-1825006-9  
GDS10S04=DIP SW,SLIDE,SMTTE 产品编号1-928836-2  
MOD2 PIN WITH A-PIN L/PTE 产品编号7-2176246-6  
CRGS2512 5% 1M8TE 产品编号3-1415020-1  
PT570N20TE 产品编号4-2176391-7  
RQ 1206 37K4 0.1% 10PPM 5K RLTE 产品编号2176314-4  
MELF SMA\_A 180R 0.1% 15PPM 0102  
0.3WTE 产品编号1-1437581-1  
ASE22RL=AUTOSLIDE DP

## 文档

### 产品图纸

38 MODII HDR SRST UNSHRD STKG

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_8-146455-8\_B.2d\_dxf.zip



英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-146455-8\\_B.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_8-146455-8\\_B.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[AMPMODU Interconnection System](#)

[AMPMODU Interconnection System](#)

英文版本